

# 東京エレクトロン

## 2009年3月期 第3四半期 決算説明会

2009年2月5日

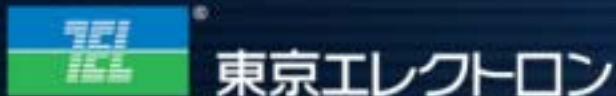
### 資料取扱い上の注意

#### 将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

#### 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



# 2009年3月期 第3四半期 決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2009年2月5日

## 2009年3月期 第3四半期決算(連結)

# 第3四半期業績

(単位: 億円)

	3Q			1Q-3Q 累計		
	FY08	FY09	対前年増減	FY08	FY09	対前年増減
売上高	1,998	1,010	-49.4%	6,762	4,023	-40.5%
SPE	1,607	578	-64.0%	5,399	2,665	-50.6%
FPD/PVE	100	203	102.7%	536	605	12.9%
EC/CN	289	228	-21.2%	822	749	-8.9%
その他	0	0	-20.9%	3	2	-15.8%
売上総利益	724 (36.2%)	271 (26.8%)	-62.6%	2,377 (35.2%)	1,181 (29.4%)	-50.3%
販管費	339	291	-48億円	1,042	938	-103億円
営業利益	384 (19.3%)	-20 (-2.0%)	-405億円	1,335 (19.7%)	242 (6.0%)	-1,092億円
経常利益	397	-0	-398億円	1,355	288	-1,067億円
税前利益	400	-84	-485億円	1,382	201	-1,180億円
当期純利益	256	-76	-332億円	880	96	-783億円
研究開発費	159	143	-15億円	478	459	-19億円
設備投資額	41	27	-13億円	169	132	-36億円
減価償却実施額	55	59	+3億円	153	166	+13億円

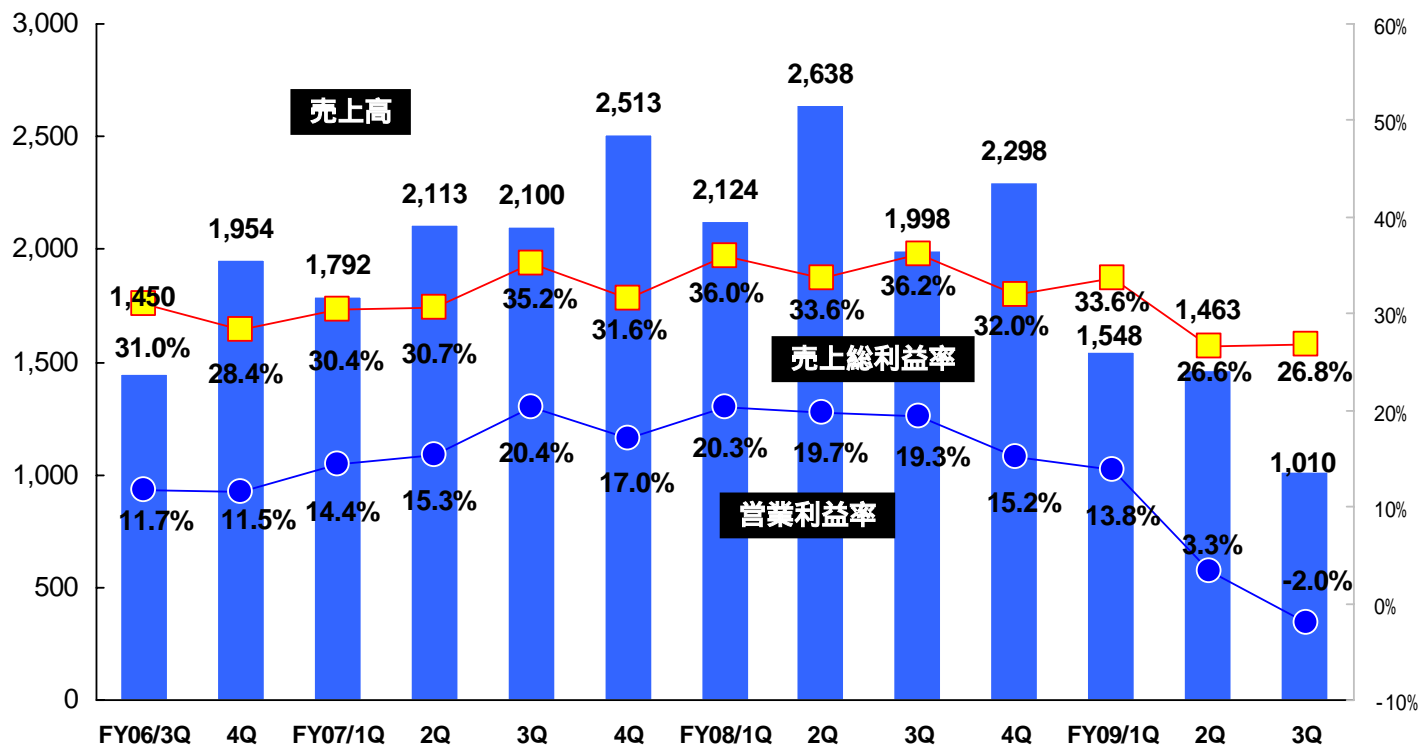
SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク



# 2009年3月期 第3四半期決算(連結)

## 売上・利益率推移

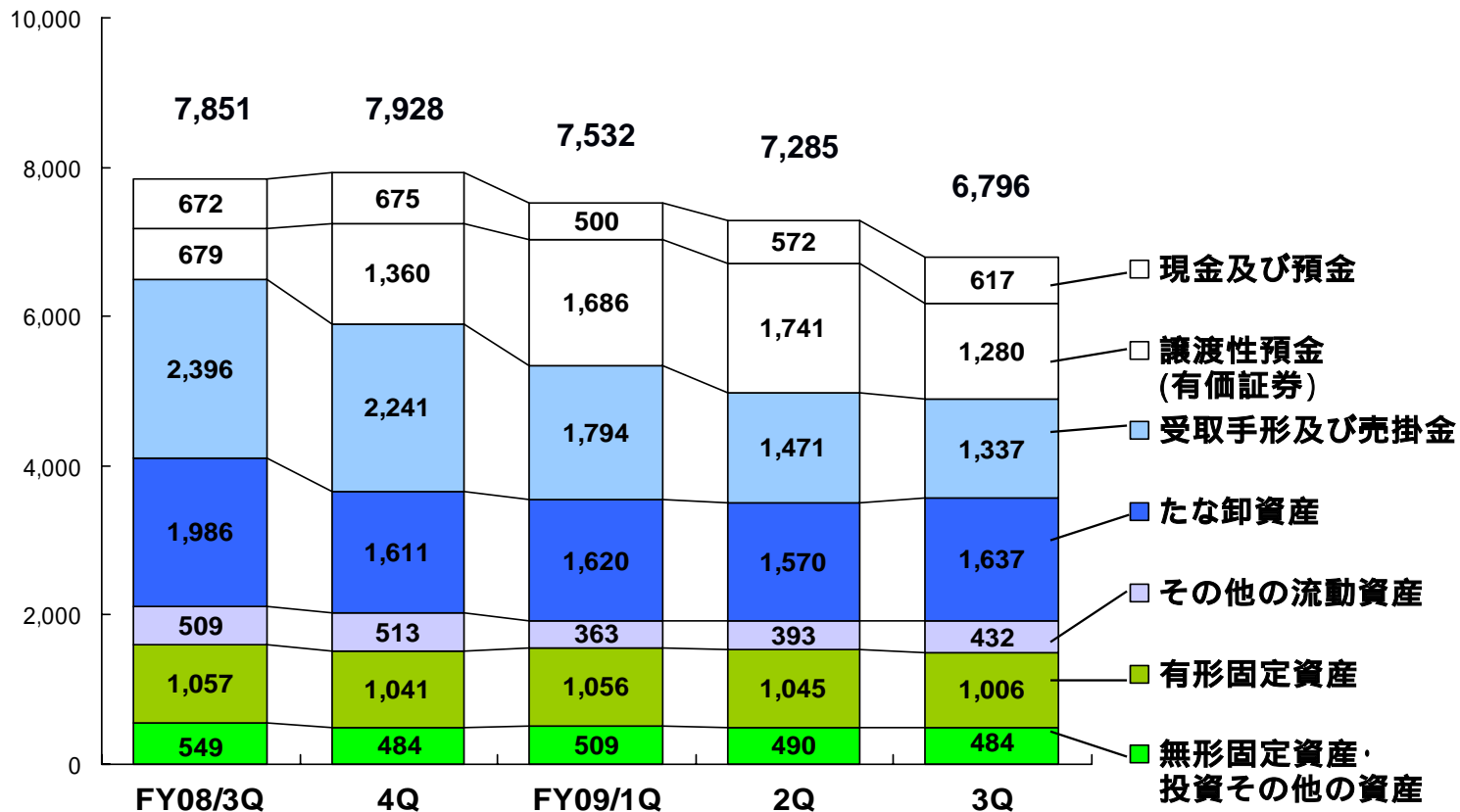
(単位: 億円)



## 2009年3月期 第3四半期決算(連結)

# 資 産

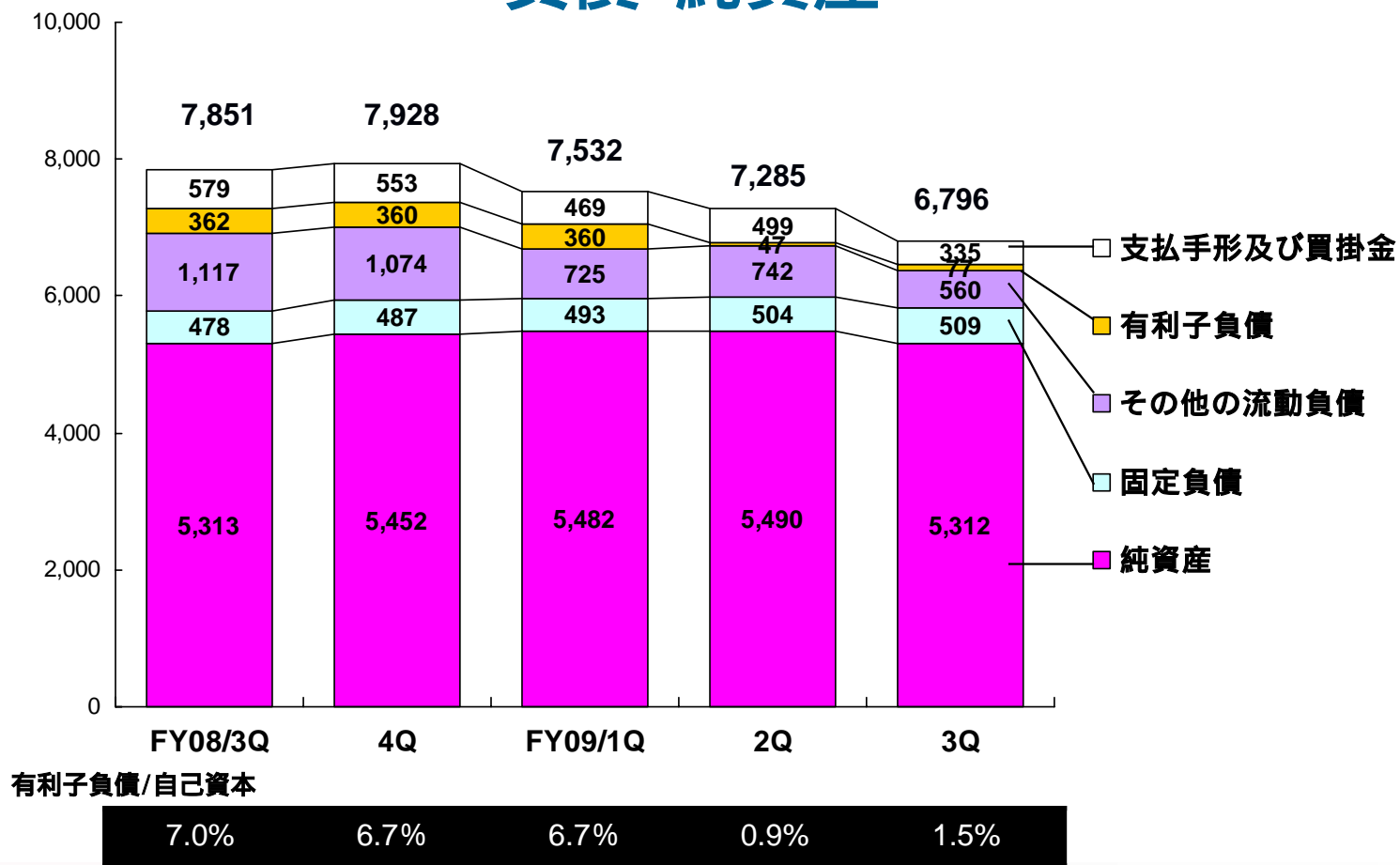
(単位:億円)



## 2009年3月期 第3四半期決算(連結)

# 負債・純資産

(単位:億円)

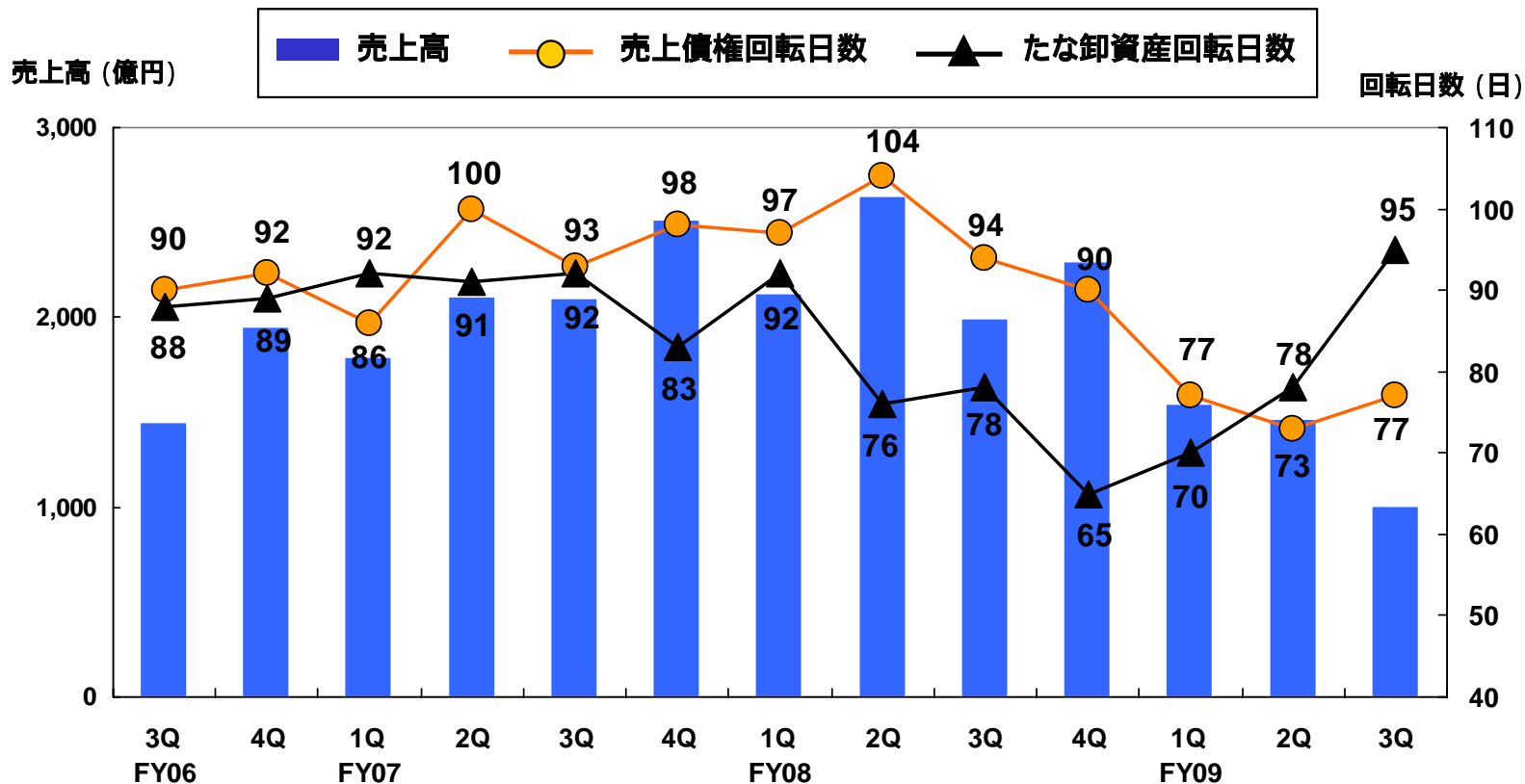


\* 自己資本 = 純資産 - (新株予約権 + 少数株主持分)



# 2009年3月期 第3四半期決算(連結)

## たな卸資産・売上債権の回転日数



\*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



## 2009年3月期 第3四半期決算(連結)

# キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	2008年3月期	2009年3月期	
	1Q-3Q (9ヶ月)	1Q-3Q (9ヶ月)	主な内訳
営業活動によるキャッシュ・フロー	412	509	*税前利益: 201 *減価償却費: 166 *売上債権等の増減: 637 *法人税等: -411
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲474	▲1,328	*設備投資: -127 *3ヶ月超の預金への預入: -1,118
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲268	▲420	*有利子負債の減少: -282 *配当金: -134
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲1	▲14	
現金及び現金同等物の増加額	▲332	▲1,253	
現金及び現金同等物の期末残高	1,011	681	

現預金及び譲渡性預金の期末残高	1,351	1,897
-----------------	-------	-------





# 2009年3月期 第3四半期決算(連結)

## 部門別売上高

### SPE部門

(半導体製造装置)

### FPD/PVE部門

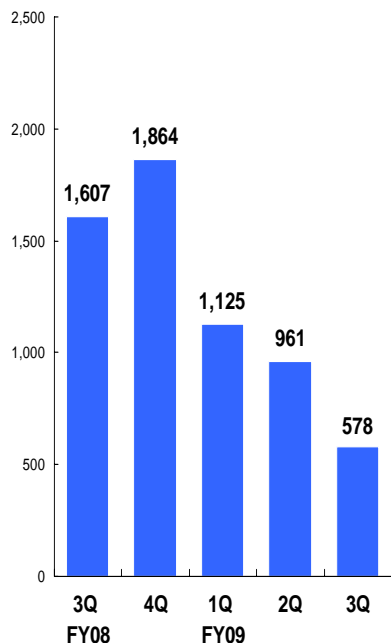
(FPD製造装置/太陽電池製造装置)

### EC/CN部門

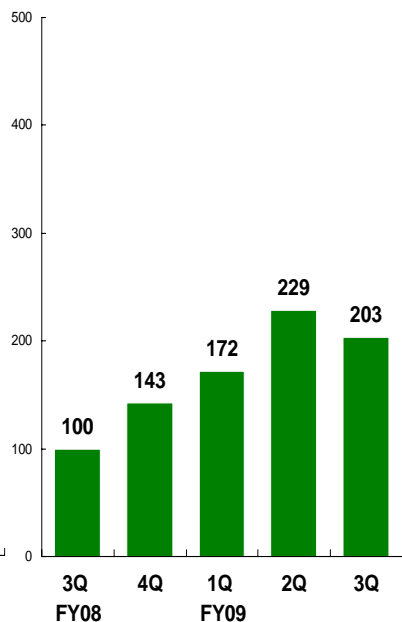
(電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

### 部門別構成比

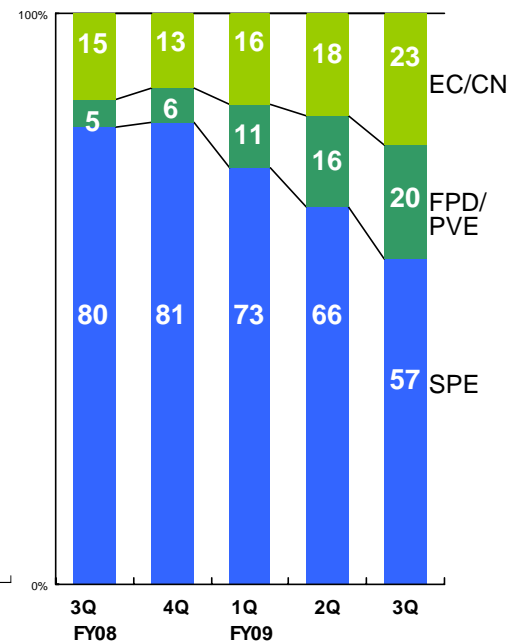
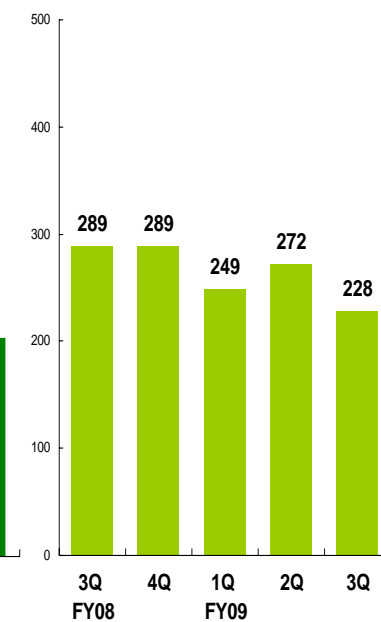
(単位: 億円)



(単位: 億円)



(単位: 億円)



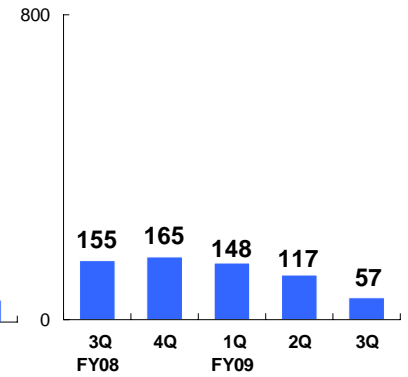
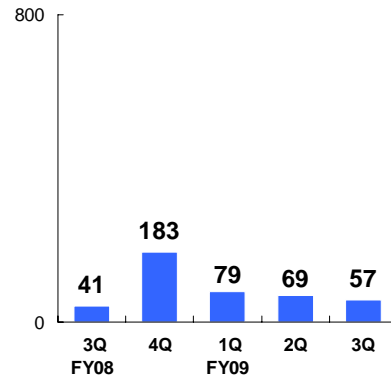
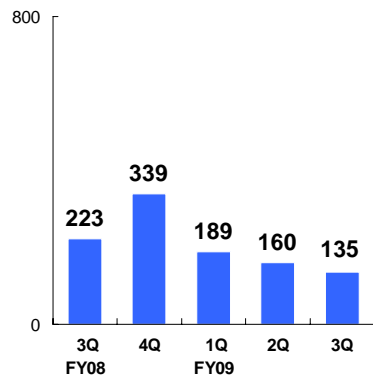
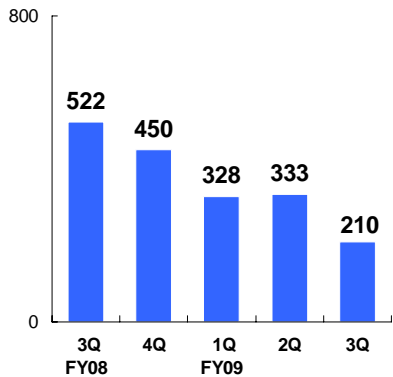
\* 上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります (FY09/3Q売上高0.5億円)。



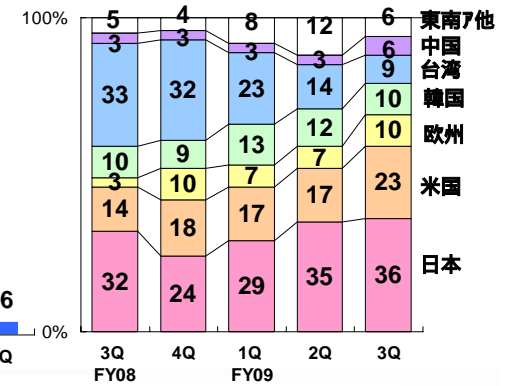
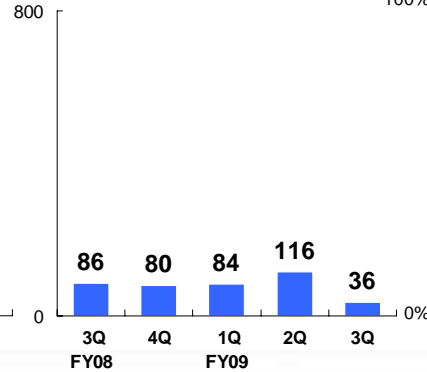
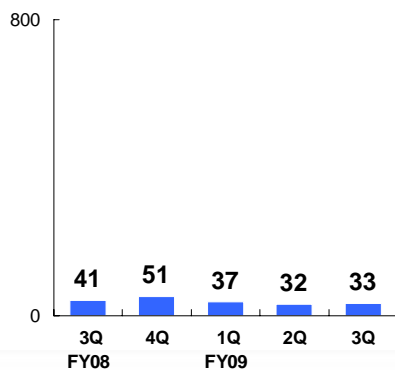
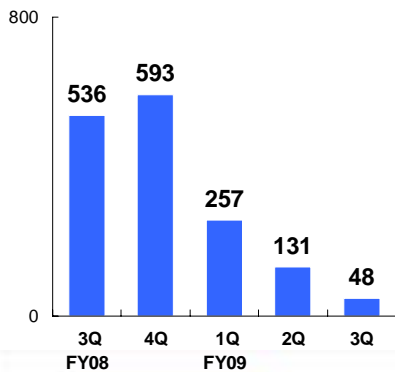
# 2009年3月期 第3四半期決算(連結) S P E 部門地域別売上高

(単位:億円)

## 日本 米国 欧州 韓国



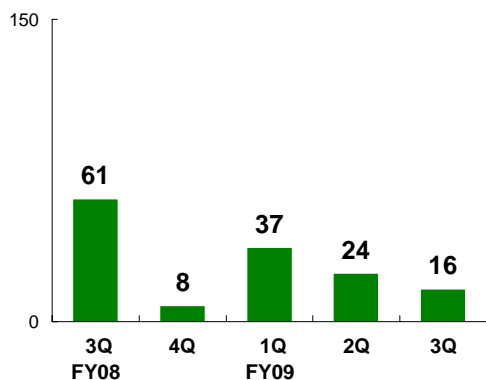
## 台湾 中国 東南アジア他 地域別構成比



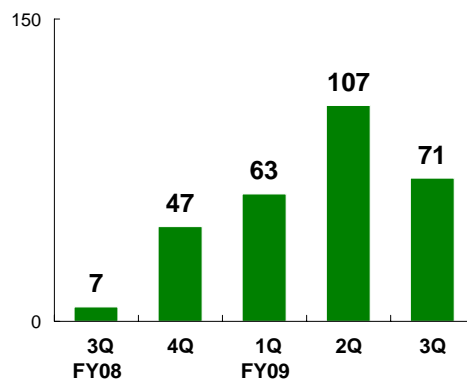
# 2009年3月期 第3四半期決算(連結) FPD/PVE部門地域別売上高

(単位:億円)

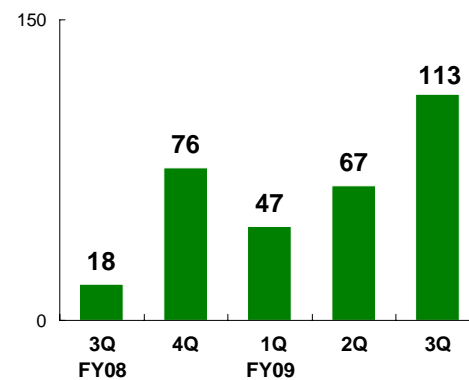
## 日本



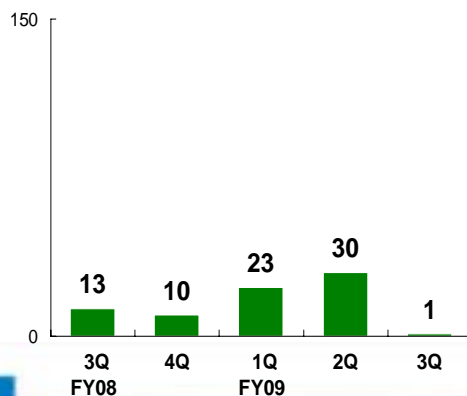
## 韓国



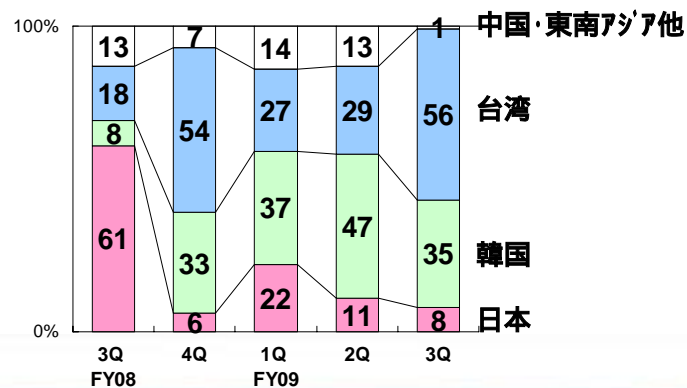
## 台湾



## 中国・東南アジア他



## 地域別構成比



# 2009年3月期 第3四半期決算(連結)

## 事業の種類別セグメント情報

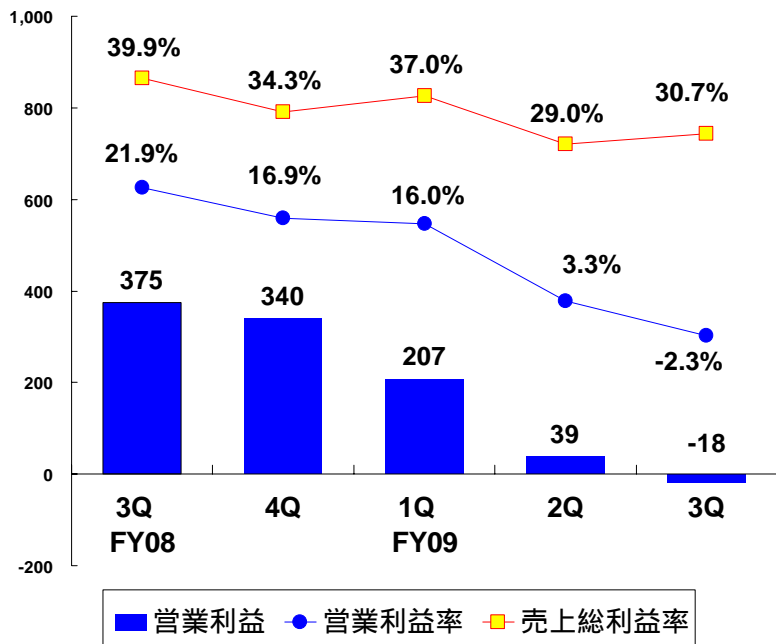
### 産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、太陽電池製造装置、その他)

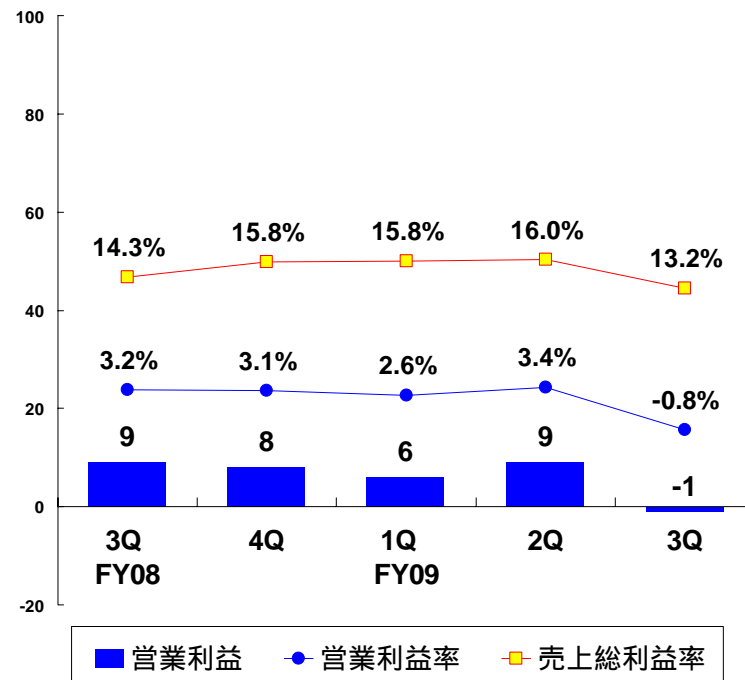
### 電子部品・情報通信機器

(半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、ミドルウェア・ソフトウェア、その他電子部品等)

(単位:億円)



(単位:億円)



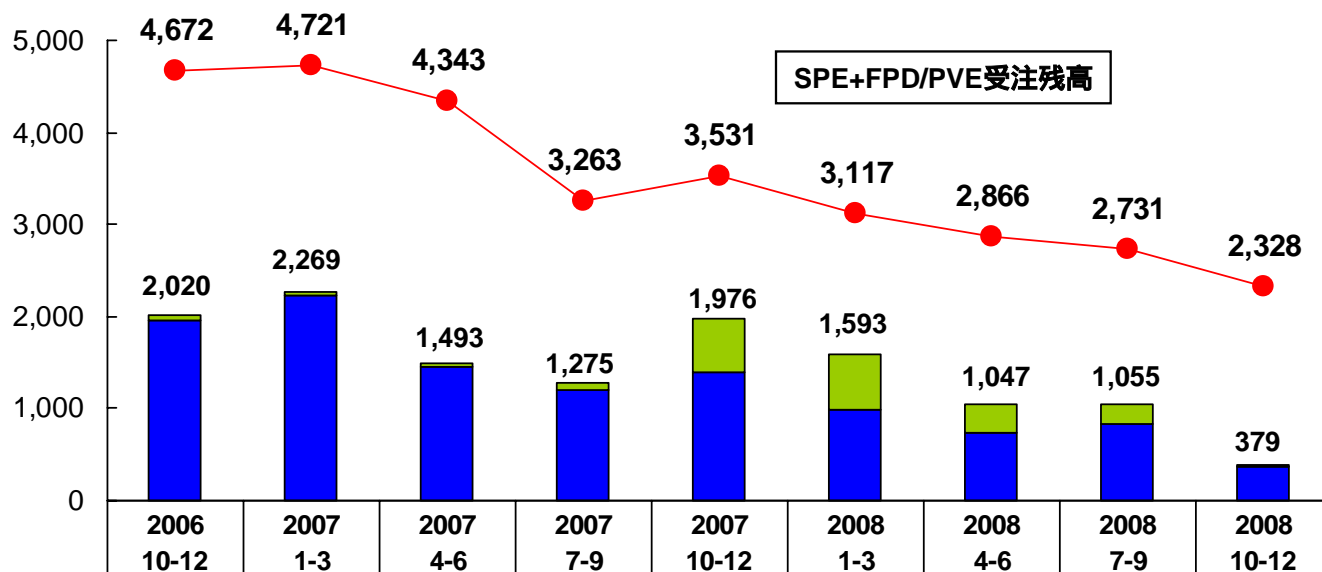
●セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



2009年3月期 第3四半期決算(連結)

# SPE+FPD/PVE受注額, 受注残高

(単位: 億円)



	2006 10-12	2007 1-3	2007 4-6	2007 7-9	2007 10-12	2008 1-3	2008 4-6	2008 7-9	2008 10-12
FPD/PV製造装置 受注額	55	42	41	73	573	610	319	217	4
半導体製造装置 受注額	1,964	2,227	1,452	1,202	1,403	983	727	837	375
受注残高	4,672	4,721	4,343	3,263	3,531	3,117	2,866	2,731	2,328

受注残高内訳	FPD/PVE	831	652	479	331	803	1,271	1,417	1,406	1,206
	SPE	3,841	4,069	3,864	2,931	2,727	1,846	1,448	1,325	1,122



